

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2003 年 9 月 25 日 (25.09.2003)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 03/078494 A1

(51) 国際特許分類⁷: C08G 8/28, C08F
290/02, 8/00, C08G 59/16

355-0215 埼玉県 比企郡 嵐山町大字平沢 9 0 0 番地
太陽インキ製造株式会社嵐山北山事業所内 Saitama
(JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP03/02930

(22) 国際出願日: 2003 年 3 月 12 日 (12.03.2003)

(74) 代理人: 吉 田 繁 喜 (YOSHIDA, Shigeki); 〒169-0075
東京都 新宿区 高田馬場二丁目 1 4 番 2 号 原田ビル
1 1 0 3 号 Tokyo (JP).

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2002-72751 2002 年 3 月 15 日 (15.03.2002) JP
特願2002-74580 2002 年 3 月 18 日 (18.03.2002) JP
特願2002-74684 2002 年 3 月 18 日 (18.03.2002) JP

(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB,
BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,
DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,
LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO,
NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU,
ZA, ZM, ZW.

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 太陽イン
キ製造株式会社 (TAIYO INK MANUFACTURING
CO., LTD.) [JP/JP]; 〒176-8508 東京都 練馬区 羽沢二
丁目 7 番 1 号 Tokyo (JP).

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY,
CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC,
NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

(72) 発明者: および

(75) 発明者/出願人 (米国についてののみ): 釜 范 裕 一 (KA-
MAYACHI, Yuichi) [JP/JP]; 〒176-8508 東京都 練馬区
羽沢二丁目 7 番 1 号 太陽インキ製造株式会社本社内
Tokyo (JP). 小 檜 山 登 (KOHIYAMA, Noboru) [JP/JP]; 〒

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される
各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: CURABLE RESINS AND CURABLE RESIN COMPOSITIONS CONTAINING THE SAME

(54) 発明の名称: 硬化性樹脂及びそれを含有する硬化性樹脂組成物

(57) Abstract: A curable resin having an unsaturated group and a carboxyl group at the end of the side chain is provided, which is obtained by, e.g., a process which comprises reacting a product (c) of reaction of a compound (a) having three or more phenolic hydroxyl groups in the molecule with an alkylene oxide (b) with an unsaturated monocarboxylic acid (d) and reacting the obtained product (e) with a polybasic acid anhydride (f). Further, photo- and heat-curable resin compositions useful in the formation of solder resists of printed wiring boards or interlayer dielectric films of multilayer wiring boards can be obtained by blending the curable resin with a photopolymerization initiator, a photosensitive (meth)acrylate compound, an epoxy compound, a diluting solvent, other curable resin which has carboxyl and unsaturated groups in the molecule and is solid at room temperatures, a flame retardant, and so on.

(57) 要約: 1 分子中に 3 個以上のフェノール性水酸基を有する化合物 (a) と、アルキレンオキシド (b) との反応生成物 (c) に不飽和基含有モノカルボン酸 (d) を反応させ、得られた反応生成物 (e) と多塩基酸無水物 (f) とを反応させて得られる硬化性樹脂など、側鎖の末端に不飽和基及びカルボキシル基を有する硬化性樹脂が提供される。このような硬化性樹脂を光重合開始剤、感光性 (メタ) アクリレート化合物、エポキシ化合物、希釈溶剤、分子中にカルボキシル基及び不飽和基を有する室温で固形の他の硬化性樹脂、難燃剤等と配合することにより、プリント配線板のソルダーレジスト、多層配線板の層間絶縁層などの形成に有用な光硬化性・熱硬化性樹脂組成物が得られる。

WO 03/078494 A1